



Dünndraht Wedge-Wedge Bonder 5630i

Bond System

Drahttypen	Alu- und Golddrähte 12,5 - 75 µm auf 2"-Spule
Bondkopf	Wedge-Wedge für Alu- und Golddrähte Motorisierte Drahtabspulung (optional)
Ultraschall System	F&S Generator 100 kHz (optional 65, 140 kHz)

Maschinen Basis

Achsen

- Arbeitsbereich X/Y-Achse 100 x 100 mm
- Schrittauflösung 1 µm programmierbar
- Programmierbare Z-Achse mit 60 mm Hub

Hardware

- Dual-Core PC mit Windows OS Ethernet
- USB 2.0/3.0, LCD Farbdisplay 22"
- GigE-CMOS-Farbkamera
- Netzwerkfähig mit Programm-Archivierung

Software

- Einzelbonds bis komplexe Programme
- Loopformen in Bibliotheken speicherbar
- Optionale Bilderkennung

Geschwindigkeit

- 1 Draht / 2 - 3 Sekunden

Platziergenauigkeit

+/- 5 µm @ 3 sigma, inkl. Tool/ohne Draht auf F&S BONDTEC Standard-Substrat

Wiederholgenauigkeit

+/- 3 µm @ 3 sigma, inkl. Tool/ohne Draht auf F&S BONDTEC Standard-Substrat

Loophöhengenaugigkeit

+/- 5 µm @ 3 sigma, bei Dünndraht 5630 mit 25 µm Aluminium Draht auf F&S BONDTEC Standard-Substrat

Die 56xxi Serie:

Der semiautomatische Gold-Ball-Bonder 5630i ist auf Basis der 56xx-Serie voll PC-gesteuert und es sind beliebig viele Bonds oder Bumps programmierbar.

Die programmierten Zielpunkte werden über das Kamerazielfadenkreuz angefahren und die programmierten Bonds oder Bumps werden automatisch gebondet.

F&S BONDTEC bietet bei dieser Maschine zwei Modis an: Singlebond zum Reparieren von div. Bond-samples und zum Setzen von Einzelbonds (manuell -automatisch) und Multiwire zum Teachen und Bonden von Chips oder div. Bondsamples (semi- u. vollautomatisch).

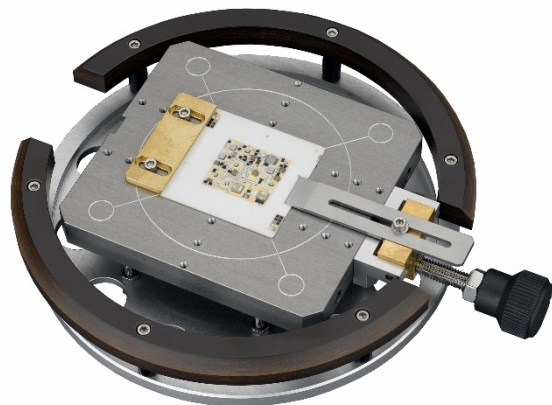
Durch einfachen Wechsel der Bondköpfe und der Software kann diese Maschine auch auf Ball-Wedge, Dickdraht Wedge Wedge oder Heavy Ribbon Bonder umgerüstet werden. Ebenso ist die Maschine als Pull-/Sheartester einsetzbar.

Werkzeugloses Umrüsten ist in ca. 3 Minuten möglich.

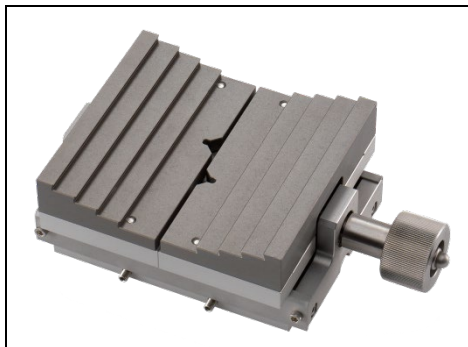
- Abmessung** B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 75 kg
- Anschlüsse** 100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 500 VA
Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
- Heizung** Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Substrathalter

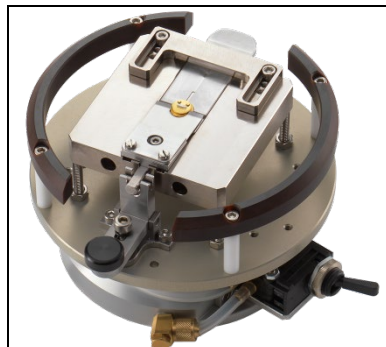
Standard-Substrataufnahme
für Bauteile bis 4x4" mit
Vakuum und mechanischer Klemmung



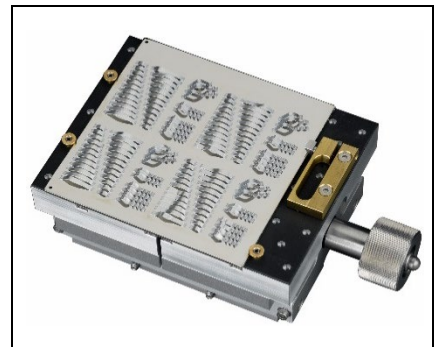
Optional:



Substrathalter 4x4"
mit Stufenbacken



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanischer Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a
A-5280 Braunau am Inn
Tel.: +43-7722-67052-8270
Fax: +43-7722-67052-8272
Mail: info@fsbondtec.at
Web: www.fsbondtec.at

